

パワーデバイス用Sintering装置(加圧・加熱接合装置) HTM-3000(標準機) HTM-1000(卓上機)



加圧仕様

- 加 圧 力 : 100N~200kN(加圧面積 : 100mm×100mm) 標準機
50N~5kN(加圧面積 : 40mm×40mm) 卓上機
ロードセルによるクローズド制御
- 加圧精度 : $\pm 0.1\%$ 以下(20MPa) 標準機
- 加圧方式 : サーボモータ方式、油圧アクチュエータ方式共可能
- サーボモータ方式 : 無段階加圧力、加圧速度調整可能
- 油圧アクチュエータ方式 : センサーによる多段階加圧制御可能

加熱・冷却仕様

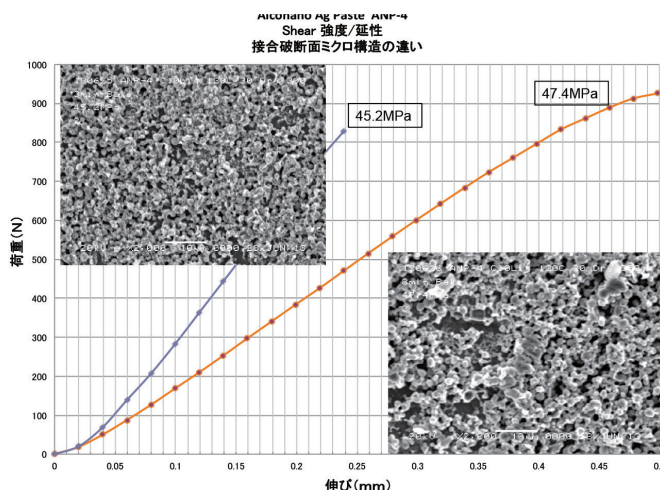
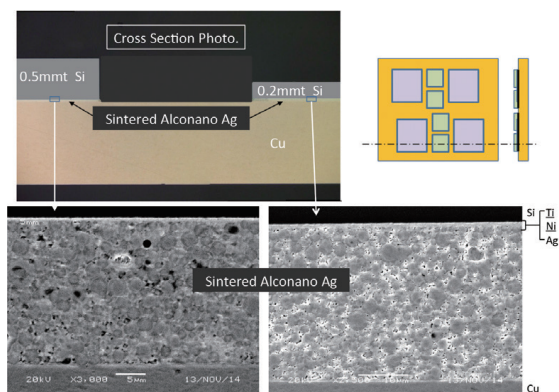
- 加熱方式 : 棒状ヒータ、セラミックヒータ、カセットヒータ
特殊ヒータ等選択可能、Dual加熱機構搭載可能
- 加熱仕様 : $1^{\circ}\text{C}/\text{秒} \sim 5^{\circ}\text{C}/\text{秒}$ 程度まで多彩に選択可能
(ヒータ及びヘッド部の材質選択による制限有)
- 加熱精度 : $\pm 1^{\circ}\text{C}(100^{\circ}\text{C})$ 、 $\pm 3^{\circ}\text{C}(300^{\circ}\text{C} \sim 350^{\circ}\text{C})$
- 冷却仕様 : 徐冷機能、強制冷却 : 空冷、油冷、水冷等選択可能
Dual冷却機構搭載可能
- 環 境 : 大気、真空、ガス封入、リフロー状態等選択可能

ワークエリア及びシンタリング方式

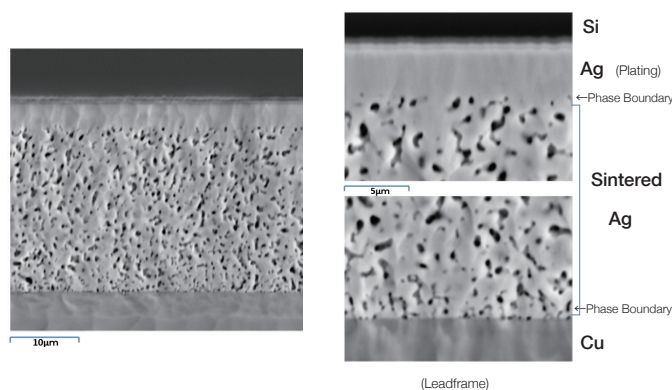
- 標 準 機 : 100mm×100mm ~ 300mm×300mm
卓 上 機 : 40mm×40mm(有効面積30mm×30mm)
- シンタリング方式 : 1ヘッド1チップ方式
1ヘッド複数基板一括方式まで可能

その他(デモンストレーション可能)

- 実験用デモンストレーション機保持
デバイス持参での実験可能 : お問い合わせください。
- 量産機 : 少量多品種型装置から大量生産機まで設計可能
トレイ、チップ搭載機、搬送系等製造ライン全体設計可能
- 装置寸法 : 標準機 約1060(W)×1540(D)×2075(H)mm
卓上機 約 360(W)× 400(D)× 780(H)mm



● 接合断面SEM像



お問合せ先

伯東株式会社

関西支店 電子機器営業グループ 営業担当 志津野 F1@hakuto.co.jp
〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-6アクロス新大阪5F TEL 06-6350-8913(直)

<http://www.hakuto.co.jp>